

Neue Impulse für HF-Anwendungen



Eine neue Lösung von LPKF ermöglicht, zeit- und platzsparend gehäuseintegrierte Antennen in SiPs zu erzeugen. Das Active Mold Packaging (AMP) genannte Verfahren arbeitet mit Laser Direct Structuring (LDS). Anschließend werden die gelaserten Bereiche selektiv mit Kupfer metallisiert. Für HF-Anwendungen in den Branchen Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie oder Luft- und Raumfahrt ist Active Mold Packaging (AMP) ein raumsparendes, einfaches und zuverlässiges Verfahren zur Integration planarer Antennen direkt in oder auf Packages. Das neue Verfahren im Bereich der Aufbau- und Verbindungstechnologie (AVT) für Fertigung von integrierten Schaltkreisen (ICs) wandelt bisher nicht genutztes Volumen der Epoxid Vergussmasse (Epoxy Mold Compound EMC) eines ICs in einen aktiven Träger der elektrischen Funktionalität um.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)